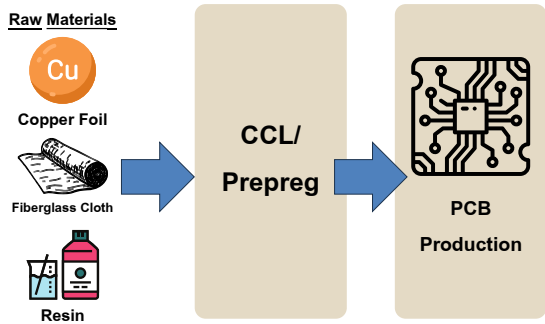


## ภาพรวมอุตสาหกรรม

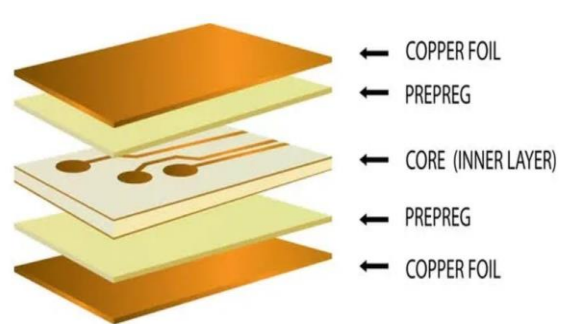
- Copper Clad Laminate (CCL)** คือ วัสดุพื้นฐานสำคัญในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) ซึ่งประกอบด้วยแกนกลาง (core) ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชุบเรซินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบางบนผิวด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน โครงสร้างดังกล่าวเอื้อต่อการนำไปผ่านกระบวนการทางเคมี เช่น การพิมพ์ลาย การกัดทองแดง การชุบเคลือบ เพื่อสร้างลวดลายวงจรไฟฟ้าตามแบบที่ออกแบบไว้ ทั้งนี้ CCL จึงทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างรองรับทางกลและวัสดุนำไฟฟ้าในจุดที่ต้องการ โดยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เสถียร ทนความร้อน จึงเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท ทั้งสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ 5G ไปจนถึงระบบควบคุมในอุตสาหกรรมขั้นสูง ทำให้ CCL เป็นวัสดุต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
- Prepreg** คือ วัสดุไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการชุบด้วยเรซินในสถานะกึ่งแข็งตัว (เรียกว่า B-stage) ซึ่งยังไม่แข็งตัวสมบูรณ์ ทำให้สามารถหลอมและเชื่อมประสานกับชั้นวัสดุอื่นได้เมื่อผ่านกระบวนการกีดด้วยความร้อนและแรงดัน โดย Prepreg ทำหน้าที่เป็นทั้งวัสดุยึดประสาน (adhesive) และฉนวนไฟฟ้า (dielectric layer) ระหว่างชั้นทองแดงและแผ่น core ในการผลิตแผงวงจรพิมพ์หลายชั้น (multilayer PCB) โครงสร้างของ Prepreg มีความสำคัญต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า ความหนา ความแข็งแรง และเสถียรภาพของวงจรไฟฟ้า โดยสามารถควบคุมค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) และค่าการสูญเสียสัญญาณ (loss tangent) ให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์ AI, อุปกรณ์ 5G และยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น Prepreg จึงเป็นวัสดุเชิงวิศวกรรมที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม PCB สมัยใหม่ โดยเฉพาะในยุคที่ต้องการวงจรที่บาง เบา ชับซ้อน และมีความเสถียรสูง
- ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม CCL/Prepreg** แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ (raw material suppliers) ซึ่งจัดหาทองแดงฟอยล์ ไฟเบอร์กลาส และเรซิน ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต CCL และ Prepreg โดยวัตถุดิบเหล่านี้มักต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความบริสุทธิ์สูง ความบางสม่ำเสมอ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่แม่นยำ และอัตราการสูญเสียสัญญาณต่ำ ซึ่งวัตถุดิบคุณภาพสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ทำให้ประเทศที่ไม่มีฐานผลิตต้นน้ำต้องเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนผันผวนและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ 2) ผู้ผลิตแผ่นลามิเนต CCL และ Prepreg ซึ่งเป็นการผลิตขั้นกลางน้ำ ทำหน้าที่นำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการชุบเรซิน เคลือบทองแดง และกดลามิเนต เพื่อสร้างแผ่น CCL ที่มีคุณสมบัติทั้งทางกลและทางไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งานในแผงวงจรพิมพ์ โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิต CCL มักจะผลิต Prepreg ควบคู่ไปด้วยในสายการผลิตเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบพื้นฐานและเทคโนโลยีการแปรรูปที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การผลิตควบคู่กันช่วยลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองคำสั่งของลูกค้า และช่วยให้ควบคุมคุณภาพวัสดุได้อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก เช่น Kingboard, Shengyi, EMC และ Nan Ya Plastics ต่างมีสายการผลิต CCL และ Prepreg ครบวงจร 3) กลุ่มผู้ใช้ปลายน้ำ (Downstream Users) ได้แก่ โรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB Fabricators) ซึ่งนำ CCL/Prepreg ไปผลิตเป็น PCB ที่มีลวดลายวงจรตามแบบ และจัดจำหน่ายต่อไปให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 5G และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

## รูปที่ 1 Value Chain ของอุตสาหกรรม CCL/Prepreg



ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

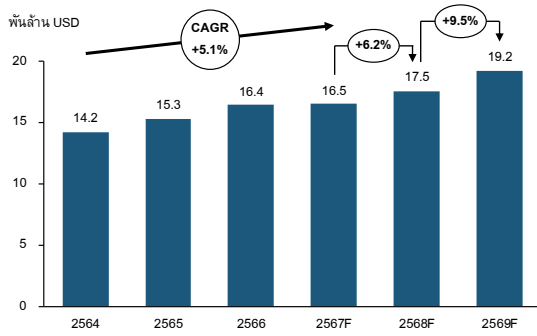
## รูปที่ 2 โครงสร้างของ Multi-Layer CCL



ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

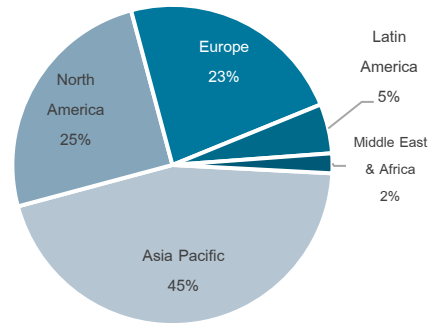
- ในช่วงปี 2564-2567 มูลค่าตลาดของ CCL ทั่วโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 16.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 19.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ราว 6.2% ต่อปีในช่วงปี 2566-2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 5G, Edge AI, อุปกรณ์ IoT และ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีความต้องการใช้แผงวงจรความหนาแน่นสูง (HDI และ SLP) ส่งผลให้ความต้องการใช้ CCL เกรดพิเศษ เช่น high-frequency, low-loss, halogen-free และ ultra-thin copper foil เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI, radar-based ADAS (Advanced Driver Assistance System) และโมดูลความถี่สูงใน EV ซึ่งต้องการคุณสมบัติของวัสดุที่แม่นยำสูงทั้งในด้านค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและอัตราการสูญเสียพลังงานต่ำ (Dissipation Factor)
- ในด้านโครงสร้างการแข่งขันตลาด CCL ของโลกมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยผู้ผลิตชั้นนำส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียแปซิฟิก และมีความสามารถในการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ เช่น ทองแดงฟอยล์ ไฟเบอร์กลาส เรซิน ตลอดจนสายการผลิตลามิเนตคุณภาพสูง โดยมีผู้เล่น 5 รายหลัก ได้แก่ Kingboard Holdings (ฮ่องกง), Shengyi Technology (จีน), Nan Ya Plastics และ ITEQ Corporation (ไต้หวัน) และ Doosan Corporation (เกาหลีใต้) ซึ่งรวมกันครองส่วนแบ่งรายได้รวมกว่า 60% ของมูลค่าตลาดโลก โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้ขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนามและไทย อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ
- หากพิจารณาด้านการกระจายตลาดเชิงภูมิภาพพบว่า เอเชียแปซิฟิกยังคงครองส่วนแบ่งสูงสุดด้วยสัดส่วนตลาดราว 45% ของตลาดโลก ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ 25% และยุโรป 23% ตามลำดับ โดยจีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค CCL รายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของปริมาณการใช้ CCL ทั้งหมด ขณะที่ไต้หวันและเกาหลีใต้เน้นที่การผลิตวัสดุเกรดพรีเมียมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงและโมดูลในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ ทั้งนี้ มีแนวโน้มที่น่าสังเกตคือการที่ประเทศในอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในฐานะฐานการผลิต PCB และ Final Assembly สำหรับอุปกรณ์สื่อสารและ EV ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการ CCL และ Prepreg ภายในภูมิภาคขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะกลางถึงยาว

รูปที่ 3 มูลค่าตลาด CCL ของโลก



ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

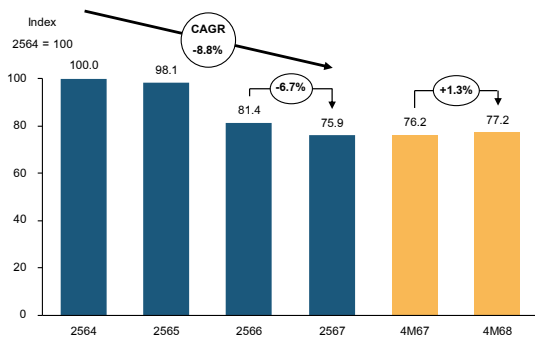
รูปที่ 4 ส่วนแบ่งตลาด CCL จำแนกรายภูมิภาค, 2566



ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

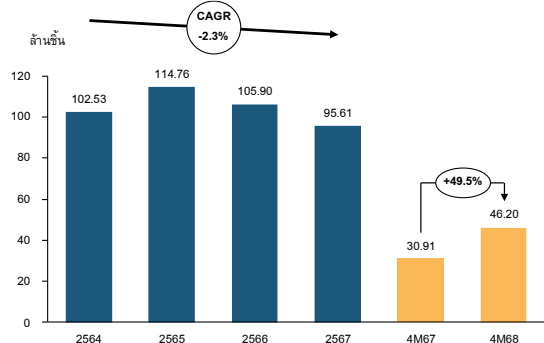
- ในประเทศไทยผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม Copper Clad Laminate (CCL) ยังมีจำนวนไม่มากนัก โดยผู้เล่นหลักที่มีบทบาทชัดเจนที่สุดคือ บริษัท ไทยลามีเน็ตแมนแฟคเจอร์ จำกัด (TLM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KCE Electronics Plc. หนึ่งในผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) รายใหญ่ของไทยและเอเชีย ซึ่งการที่ KCE ลงทุนในสายการผลิต CCL ภายในประเทศผ่าน TLM ถือเป็นรูปแบบของการผสานแนวตั้ง (vertical integration) ที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุน คงความสม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบ และลดการพึ่งพาการนำเข้าจากผู้ผลิต CCL ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรม CCL ภายในประเทศยังมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต และวัตถุดิบต้นน้ำที่ต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด รวมถึงขนาดตลาดภายในประเทศที่ยังจำกัดเนื่องจากผู้ผลิต PCB ส่วนใหญ่ในไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบ CCL จากโรงงานตามสเปกในคำสั่งซื้อที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิต CCL ภายในประเทศไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2566-2567 แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิต PCB ชั้หน้า โดยเฉพาะจากไต้หวันมายังไทยเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนจากการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของกลุ่มบริษัทไต้หวัน อาทิ ITEQ Corporation, Taiwan Union Technology Corporation และ Gold Circuit Electronics ที่มีมูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำของ PCB โดยเฉพาะในสายการผลิต CCL/Prepreg เพื่อสนับสนุนการผลิตขั้นปลายน้ำที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก
- สำหรับความต้องการใช้ CCL ภายในประเทศช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของกลุ่ม PCB ที่ขยายตัว 1.3%YoY ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหลังจากเข้าสู่ภาวะชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงปี 2564-2567 อันเป็นผลจากการปรับฐานของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ (electronics down-cycle) หลังสิ้นสุดช่วงเร่งซื้ออุปกรณ์ไอทีในช่วงโควิด-19 การบริหารสินค้าคงคลังของผู้ผลิตทั่วโลก และปัจจัยความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานสารกึ่งตัวนำจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต้นปี 2568 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยพบว่าปริมาณการจำหน่าย PCB ภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 49.5%YoY และมูลค่าการส่งออก PCB ขยายตัว 14.3%YoY ซึ่งเป็นผลจากคำสั่งซื้อที่ฟื้นตัวในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์ AI, อุปกรณ์สื่อสาร 5G และยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีปัจจัยเฉพาะหน้าจากการเร่งส่งออกล่วงหน้า (frontload) ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีลูกค้าในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งต้องการลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่คาดว่าจะเริ่มมีผลในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ทั้งนี้ การฟื้นตัวของตลาด PCB ย่อมส่งผลดีต่อความต้องการใช้ CCL ภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

รูปที่ 5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของ PCB



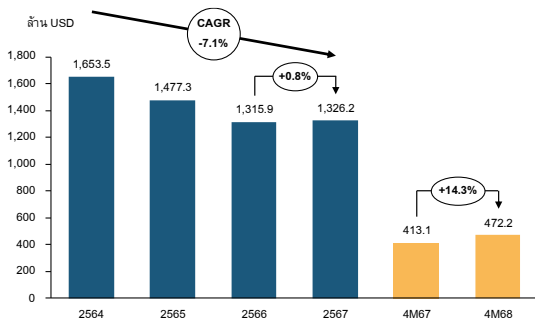
ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากข้อมูล OIE

รูปที่ 6 ปริมาณการจำหน่าย PCB ภายในประเทศ



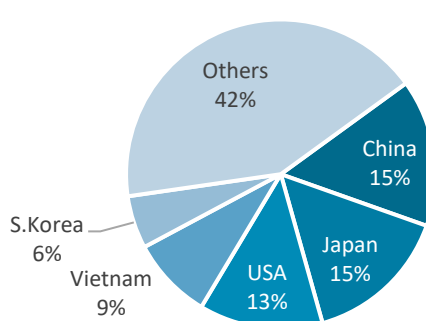
ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากข้อมูล OIE

รูปที่ 7 มูลค่าการส่งออก PCB ของไทย



ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากข้อมูล MOC

รูปที่ 8 ตลาดส่งออก PCB ที่สำคัญของไทย, 2567



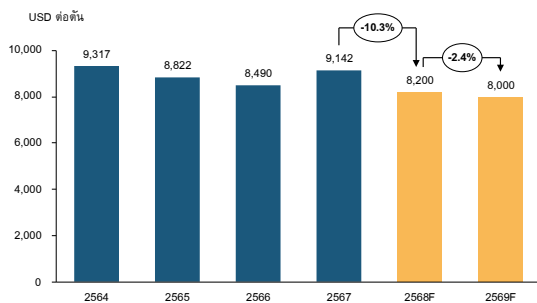
ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากข้อมูล MOC

## แนวโน้มอุตสาหกรรม

- อุตสาหกรรม Copper Clad Laminate (CCL) และ Prepreg ของไทยในช่วงปี 2568-2569 มีแนวโน้มเติบโตตามการกลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), เซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์สื่อสาร 5G ซึ่งต้องการแผงวงจรความหนาแน่นสูง (HDI, Multilayer PCB) และวัสดุฐานที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทั้งด้าน dielectric performance, thermal reliability และ low signal loss คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ความต้องการใช้ CCL/Prepreg เติบโตขึ้นในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการวงจรความแม่นยำสูงและทนสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า-ความร้อนได้ดี โดยข้อมูลจาก **Prismark Partner LLC** บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด PCB ทั่วโลกในระยะต่อไปจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-6% ซึ่งจะส่งผลให้ดีมานด์ CCL/Prepreg ขยายตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม downstream เช่น เวียดนาม และมาเลเซีย สำหรับไทยแล้วสถานการณ์นี้เปิดโอกาสให้ไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน หากสามารถดึงดูดการลงทุน upstream และพัฒนา local supplier base ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การขยายฐานการผลิตของผู้ผลิตได้หัว เช่น ITEQ Corporation และ Taiwan Union Technology Corporation (TUC) ซึ่งยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมกว่า 30,000 ล้านบาท ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจน โดยการลงทุนดังกล่าวครอบคลุมการผลิต CCL/Prepreg สำหรับ HDI board โดยเฉพาะ และมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่พร้อมรองรับ หากไทยสามารถเร่งยกระดับบุคลากรและสร้าง

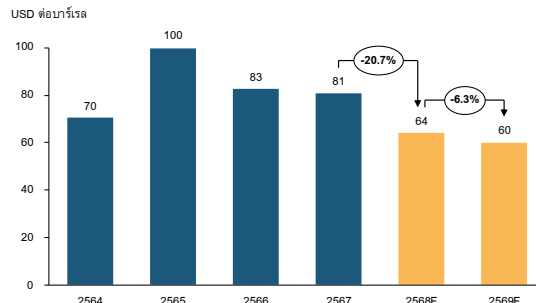
- ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับโรงงาน PCB ที่มีอยู่แล้วในประเทศได้ ก็จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างยั่งยืนในระยะถัดไป
- ในด้านต้นทุน แนวโน้มการชะลอตัวของราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะทองแดงและน้ำมัน จะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ผลิตไทย ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมด โดยข้อมูลจาก **World Bank** คาดการณ์ว่าราคาทองแดงจะปรับลดลงเฉลี่ย 6.5% ต่อปี และราคาน้ำมันดิบจะลดลงเฉลี่ย 13.8% ต่อปีในช่วงปี 2567–2568 จากภาวะอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงชั่วคราว ประกอบกับการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน ปัจจัยดังกล่าวจะเอื้อต่อการลดต้นทุนวัตถุดิบที่มีสัดส่วนสูงในโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรม เช่น ทองแดงฟอยล์และสารเรซินที่ผลิตจากอนุพันธ์ปิโตรเลียม เมื่อพิจารณาควบคู่กับคำสั่งซื้อที่เริ่มทยอยฟื้นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำจะยิ่งสนับสนุนการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นในระยะสั้นถึงกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตที่สามารถบริหารต้นทุนเชิงรุกผ่านการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว (forward contracts)
  - อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม CCL/Prepreg ของไทยยังถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่งเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา จึงยังขาดองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านบุคลากรเฉพาะทาง เช่น วิศวกรกระบวนการผลิตลามิเนต วิศวกรเคมีโพลีเมอร์ และนักพัฒนาสูตรเรซิน ซึ่งยังมีจำนวนจำกัดในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลักในระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังไม่มีฐานอุตสาหกรรมวัตถุดิบต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็นผ้าไฟเบอร์กลาส ทองแดงฟอยล์ หรือเรซินชนิดพิเศษ เช่น BT, PPE และ LCP ทำให้ต้องนำเข้าวัตถุดิบแทบทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากค่าขนส่งและความผันผวนของราคาสลัดโลก แต่ยังเพิ่มความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานจากปัจจัยภายนอก เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าหรือภาวะตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ เริ่มต้นใช้มาตรการภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ก็อาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับจีนหรือไต้หวันอย่างมีนัยสำคัญ

รูปที่ 9 ประมาณการราคาทองแดงตลาดโลก



ที่มา : World Bank (ข้อมูล ณ เม.ย. 68)

รูปที่ 10 ประมาณการราคาน้ำมันตลาดโลก (Brent)



ที่มา : World Bank (ข้อมูล ณ เม.ย. 68)

## ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นายธรรณล ศรีทองเดิม ([taratnons@lhbank.co.th](mailto:taratnons@lhbank.co.th))

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

### Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

LH BANK BUSINESS RESEARCH



**ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์**  
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



**ณัฐชาติ วิรุฬหอัศว**  
นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



**ธรรตล ศรีทองเต็ม**  
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



**เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา**  
นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



**วิสันดา ดิสรเตตวิวัฒน์**  
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



**วัชรพันธ์ นิยม**  
นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



**ณวัชร หันสุเวช**  
นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)



**ศรีอำไพ อิงคกิตติ**  
นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

จับใจ

เข้าใจ

ตอบโจทย์



Scan Here  
For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง